



Director or Sr. Manager/Technical Program Management

シンガポール本社 | 外資系OSAT企業 | 英語力を活かしてグローバルに活躍 | WFH◎

募集職種

採用企業名

UTAC Japan 株式会社

求人ID

1560653

部署名

Japan sales

業種

電気・電子・半導体

会社の種類

外資系企業

雇用形態

正社員

勤務地

京都府, 京都市下京区

給与

800万円 ~ 1200万円

勤務時間

8:30~17:15 (休憩時間1時間)

休日・休暇

土日祝日 / 夏季・年末年始休暇

更新日

2025年10月09日 15:12

応募必要条件

職務経験

10年以上

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒 : 学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

◀ Job Description & Position Highlights ▶

- Serves as the technical liaison for semiconductor back-end processes, handling customer support and project

management

- A critical technical role connecting the Japanese market with overseas factories
- Opportunity to leverage English skills and management abilities through collaboration with global teams
- Work style options include Kyoto office or remote work

【 Job Responsibilities】

This position is responsible for managing the preliminary and post sales technical requirements of new and existing customers as primary on semiconductor package assembly projects. Act as the first point of contact for technical inquiries, coordinate with the Sales and Operation teams to execute customer's requests.

■Department/Group: Japan sales

■Reporting Manager Title, Function: Head of Japan sales

■No. of Direct Reports: TBD

<Primary Responsibility>

- Manage the preliminary and post sales technical requirements of new and existing customers on semiconductor package assembly projects.
- Present technical product and services offerings to potential and existing customers.
- Act as the first point of contact for technical inquiries, coordinate with the Sales and Operation teams to execute customer's requests.
- Work as an integral part of the sales process, seek out new opportunities and provide technical feasibility feedback to the sales and your supervisor.
- Initiate new package requirements through Design/Simulation process and follow through to close designs with customer.
- Manage all new devices from Design to Qualification to Production Ramp.
- Review and evaluate customer's IC product packaging requirements. Provide package solutions within the packaging capability, package roadmap, process flow and design rules of the UTAC factories.

【Employment Type】

Full-time employee

【Salary】

Salary negotiable based on experience

【Working Hours】

In accordance with company regulations

【Work Location】

Kyoto or WFH

*Address: 京都府京都市下京区 中堂寺栗田町93京都市リサーチパーク6号館422号

*Travel Required: Yes

【Holidays & Leave】

In accordance with company regulations

【Benefits & Welfare】

In accordance with company regulations

《募集要項・本ポジションの魅力》

- 半導体後工程の技術窓口として顧客対応・案件管理を担当
- 日本市場と海外工場をつなぐ重要な技術ポジション
- グローバルチームとの連携で英語力・マネジメント力が活かせる
- 京都勤務または在宅勤務が選択可能な働き方

【業務内容】

シンガポールが本社の外資系企業の日本法人営業所です。

弊社は OSAT(Out-sourced Semiconductor Assembly and Test)であり、半導体後工程の組み立てと検査を国内の半導体メーカーのお客様から請け負い、海外4か国にあるグループ工場でおこなっています。

お客様は日本の半導体メーカーになり、弊社は日本の市場をターゲットに営業を行っております。

今回は来年度定年退職になる社員 1 名の後任の方の採用になります。(2026 年 9 月定年退職)

このポジションは新規・既存のお客様の技術的な問い合わせの最初の窓口となり、営業チームや海外工場オペレーションチームと連携し増加する日本市場でのお客様のご要望にお応えしていく業務になります。

実務でビジネスレベルの英語力は必須です。

■部署・グループ：日本営業部

■直属の上司の役職・職務：日本営業部長

■直属の部下数：未定

<具体的な業務>

- 半導体パッケージの組立プロジェクトにおいて、新規および既存の顧客の販売前および販売後の技術的な要件を管理する。
- 見込みの顧客および既存顧客に対して、製品およびサービスの技術的な提案を行う。
- 技術的な問い合わせの最初の窓口となり、営業チームやオペレーションチームと連携し、お客様の要望を実現する。
- 営業プロセスの重要な一員として、新しい機会を模索し、営業と上司に技術的な実現可能性をフィードバックする。
- 設計/シミュレーションプロセスを通じて新しいパッケージの要件を開始し、顧客との設計を完了させるまでフォローする。
- 設計から品質保証、生産立ち上げまで、すべての新規デバイスを管理する。

- 顧客の IC 製品のパッケージング要件をレビューし、評価する。パッケージングケーパビリティ、パッケージロードマップ、プロセスフロー、UTAC 工場のデザインルールの範囲内でパッケージソリューションを提供する。
- プロジェクトの技術仕様を決定し、生産の立ち上げを含む全ての品質保証の構築と調整。顧客から工場への品質保証ロットの要求事項を特定し、明確にする。
- 顧客の QBR(四半期ビジネスレビュー)の技術的な側面に対処する。
- 品質に関する問題を工場と調整し、顧客と解決する。製造上の技術的な問題に対する顧客危機管理低歩留り分析、CAR(改善処置報告書)、DOE(実験計画)のための顧客と工場間のインターフェイスになる。

【雇用形態】

正社員

【給与】

経験考慮の上、応相談

【就業時間】

会社の規定に準ずる

【勤務地】

京都 または 在宅勤務

住所:京都府京都市下京区 中堂寺栗田町93京都リサーチパーク6号館422号

※出張有

【休日休暇】

会社の規定に準ずる

【待遇・福利厚生】

会社の規定に準ずる

スキル・資格**【Application Requirements】**

- Engineering Degree with 10+ years minimum work experience preferably in the sub-con semiconductor industry or equivalent in IC assembly related companies or semiconductor environment.
- Must have experience working with advanced packages
- Good knowledge of FOL (front-of-line)and EOL (end-of-line) assembly operations
- Preferably to have a Test engineering experience
- Well versed in SPC and DOE
- Must have strong verbal, written, interpersonal communication and presentation skills both in
- Japanese and English. Must enjoy working with others, highly organized, ability to take initiative/task orientated, &work with minimum supervision.

Must be a team player comfortable working with cross-functional teams across geographic boundaries with experience in leading teams and managing projects.

【応募要件】

- 工学系学位、IC 組立関連または半導体業界での 10 年以上の実務経験があることが望ましい
- アドバンストパッケージの業務経験
- FOL (front-of-line)および EOL (end-of-line)の組立作業に関する十分な知識
- テストエンジニアリング経験者優遇
- SPC および DOE に精通している
- 日本語と英語での会話、読み書き、対人コミュニケーション、プレゼンテーションのスキルがあること。他人と協力して業務を遂行し積極的に自らの仕事に取り組めること。
- チームリーダー、プロジェクトマネジメントの経験を有し、国籍など関係なくグローバルな環境、クロスファンクショナルなチームワークに慣れていること。

会社説明